

证券代码：300480

证券简称：光力科技

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260320

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中银基金：杨雷；万家基金：石韬、武玉迪、张希晨、况晓、黄兹睿、汪洋；浦银安盛基金：刘妍雪；银河基金：高鹏；上海赢韵私募：徐旺、张晓春；犁得尔私募基金：顾宇丰。
时间	2026年3月20日
地点	公司郑州航空港厂区2号楼会议室、上海
上市公司接待人员姓名	总经理、董事：胡延艳 董事会秘书：吕琦 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍了公司的业务情况，并就投资者关注的问题进行交流，部分投资者实地参观了公司生产车间和展厅区域：</p> <p>1、公司机械划片机在性能上与行业头部产品相比处于什么水平？</p> <p>答：公司国产半导体机械划切设备在切割品质和切割效率方面均可与国际头部对标型号相媲美，已经得到包括国内头部封测企业等客户的广泛认可和批量复购。</p> <p>2、2026年一季度半导体业务发货量较去年同期有何变化，公司如何提升交付能力？</p> <p>答：2026年一季度半导体业务发货量较去年同期实现明显增长，客户提货速度与提货量延续2025年下半年的良好趋势；公司通过提升航空港厂区现有产能的生产效率以及充分利用高新厂区的基础设施扩充产能。同时，航空港厂区二期项目已经开始建设，预计在2027年一季度全部建成，为更好的满足客户的交付需求，公司将采取边建设边投产的方式。</p> <p>3、公司激光开槽机、激光隐切机等新设备目前验证进展如何，预</p>

	<p>计何时实现批量出货？</p> <p>答：公司激光开槽机、激光隐切机、研磨机正在客户端验证；研磨抛光一体机正在按计划研发中。公司全力加快推进设备验证尽快形成销售订单。</p> <p>4、公司国产化半导体设备业务，定制机型收入占比情况？</p> <p>答：目前公司的机械划切设备有二十余种型号，并可以根据客户的应用场景提供定制化的解决方案。目前公司国产半导体设备出货数量以标准机型为主，但自 2025 年开始，定制共研型号设备的销量占比在逐步提升。</p> <p>5、请问公司刀片耗材是通用的吗，软刀与硬刀各自适用于切割哪些类型的器件？</p> <p>答：刀片为通用化耗材，可适配国内外市场不同品牌的划片机。软刀主要应用于各类集成电路封装类型的切割、陶瓷和玻璃等硬质材料的划切、被动元器件和传感器等器件的切割；硬刀主要用于硅晶圆、化合物半导体等材料的切割。</p> <p>子公司以色列 ADT 在软刀领域具有数十年的技术迭代和应用积累，多年来一直在为包括头部封测企业在内的全球客户提供刀片，客户认可度极高；公司国产化软刀已有部分型号实现批量供货，硬刀产品目前正在客户端验证。</p> <p>6、公司对后续资本运作及融资方面有何考虑？</p> <p>答：为确保公司半导体封测装备研发生产和业务拓展等活动有充裕资金，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)科技创新债券。本次科技创新债券发行尚需提请公司股东会审议批准以及中国银行间市场交易商协会的批准，后续进展请关注公司相关公告。</p> <p>如有其他融资计划，公司也将及时履行相关程序和信息披露义务。敬请注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 3 月 20 日